



# 2024年度（2025年3月期） 第3四半期 決算説明会

2025年1月29日  
株式会社アドバンテスト

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

# ご注意

---

## 会計基準について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている実績や見通し数値は、国際会計基準（IFRS）に基づいて作成しています。

## 将来の事象に係る記述に関する注意

- 本プレゼンテーション資料およびアドバンテスト代表者が口頭にて提供する情報には、将来の事象についての、当社の現時点における期待、見積りおよび予測に基づく記述が含まれております。これらの将来の事象に係る記述は、当社における実際の財務状況や活動状況が、当該将来の事象に係る記述によって明示されているものまたは暗示されているものと重要な差異を生じるかもしれないという既知および未知のリスク、不確実性その他の要因が内包されており、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。

## 本資料の利用について

- 本プレゼンテーション資料に記載されている情報は、各国の著作権法、特許法、商標法、意匠法等の知的財産権法その他の法律及び各種条約で保護されています。事前に当社の文書による承諾を得ない限り、法律によって明示的に認められる範囲を超えて、これらの情報を使用（改変、複製、転用等）することを禁止します。

# サマリー

## [ FY24 3Q業績 ]

### ○ 売上高/営業利益/当期利益： 四半期ベースの過去最高を記録

- ✓ コア部品に対する既存サプライヤーとの長期契約や、サプライチェーン複線化などの施策を通じ、タイムリーな部材調達および製品供給能力の確保に努め、想定を上回る製品出荷を実現
- ✓ 対米ドルの為替が想定より円安となったことも追い風 (FY24 3Q 1米ドル=想定 140円、実績 149円)

## [ 今後の見通し ]

### ○ FY24 通期業績： 業績予想を上方修正

- ✓ SoCを中心とするAI関連の旺盛なテスト需要は継続。増強した製品供給能力により従来予想に織り込み切れなかった需要増にも追従

### ○ CY25 半導体テスト市場見通し： 後半に不透明感はあるものの、引き続き強いテスト需要を見込む

- ✓ AI関連半導体の複雑化および生産拡大を背景に、引き続き強いテスト需要を見込む
- ✓ AI関連半導体以外の市場向け半導体テスト需要回復は、なお時間を要すると予想

## ○ サマリー

- 私、ダグラス ラフィーバが、今回の発表のサマリーを説明いたします。
- FY2024 3Qは、売上高、営業利益、当期利益が四半期ベースで過去最高となりました。
- 足元では、特にSoC向けで、AI関連の高性能半導体向けに旺盛なテスト需要がさらに増加しております。この強いテスト需要に対応可能な見通しとなったことから、FY2024通期の業績予想を上方修正しております。詳細は後ほど説明いたします。
- また、CY2025を見据えると、下半期は例年通り不透明ですが、テスト需要は引き続き堅調に推移すると見込んでいます。AI関連半導体以外の市場向けテスト需要は回復にまだ時間を要していますが、半導体の複雑化と生産量の増加を背景に、AI関連半導体の旺盛な需要は継続すると見込んでいます。こちらも詳細は後ほど説明いたします。
- それでは、当3Qの決算について、三橋より説明いたします。

# 2024年度第3四半期 決算報告

経営執行役員 CFO & CSO (Chief Strategy Officer)  
経営戦略本部長  
三橋 靖夫

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**<sup>®</sup>

# 四半期業績推移

(億円)

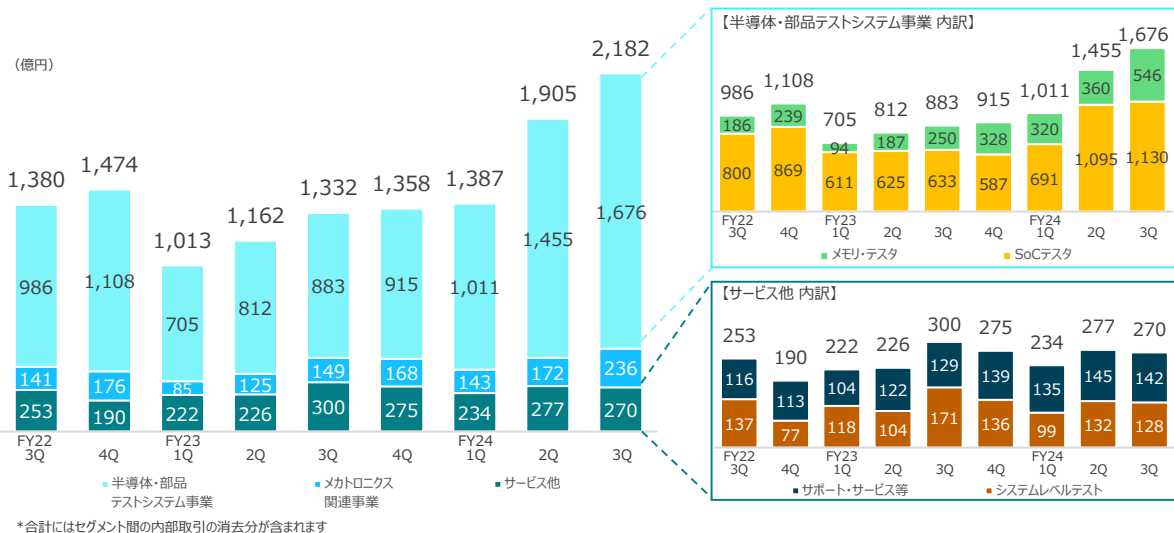
	FY23				FY24						
	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	前期比		前年同期比	
								増減額	増減率	増減額	増減率
売上高	1,013	1,162	1,332	1,358	1,387	1,905	2,182	+277	+14.5%	+849	+63.7%
売上総利益	510	580	674	696	769	1,101	1,189	+88	+8.0%	+515	+76.4%
売上総利益率	50.3%	49.9%	50.6%	51.3%	55.4%	57.8%	54.5%	-3.3pts		+3.9pts	
営業利益	143	210	268	195	313	636	692	+57	+9.0%	+424	2.6x
営業利益率	14.1%	18.1%	20.1%	14.4%	22.6%	33.4%	31.8%	-1.6pts		+11.7pts	
税引前四半期利益	130	203	263	186	319	607	706	+98	+16.2%	+443	2.7x
四半期利益	92	167	212	152	239	454	519	+64	+14.1%	+307	2.4x
四半期利益率	9.1%	14.4%	15.9%	11.2%	17.2%	23.9%	23.8%	-0.1pts		+7.9pts	
為替レート (円)	1米ドル	135	142	149	147	153	154	149	5円 円高	-	
	1ユーロ	146	156	159	159	165	168	162	6円 円高	3円 円安	
1株当たり配当額*1 (円)	-	16.25 (65)	-	18	-	19	-	-	-	-	

\*1:当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記1株当たり配当金はFY23期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しております。(カッコ内は分割前の値)

## ○ FY2024 3Qの業績概要

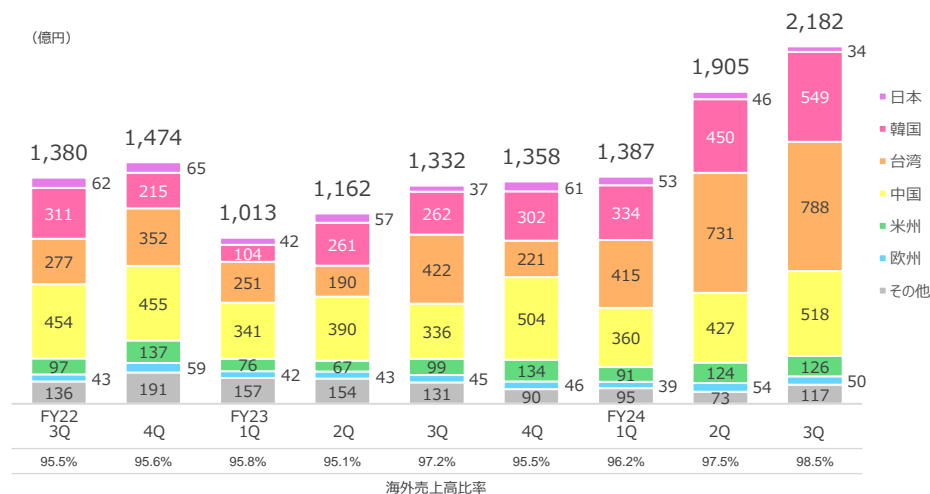
- ・ 私より、まずFY2024 3Q実績について説明いたします。
- ・ 3Q実績は、過去最高の売上、利益を記録し、営業利益率は2四半期連続で30%を超えました。
- ・ 詳細は以降のスライドで順次説明いたします。

# 四半期売上高 事業セグメント別



- FY2024 3Qの売上高
- 半導体・部品テストシステム事業
  - ・ SoCテストは、1,130億円と前期に引き続き高い売上高でした。主に高水準なHPC/AI関連向けテスト需要が牽引し、一部エッジAI関連向けの需要も貢献しました。車載や産業機器向けといった成熟プロセス品向けは、低調な売上が継続しました。
  - ・ メモリ・テストは、前期比187億円増の546億円でした。HBM向けを中心としたDRAM前工程向けの売上が伸びるとともに、DRAM後工程向けの売上也増加しました。
- メカトロニクス関連事業
  - ・ テスタの販売増に連動し、前期比でデバイス・インタフェースの売上が増えました。
- サービス他
  - ・ サポート・サービス、システムレベルテスト（SLT）ともに前期比でほぼ横ばいでした。

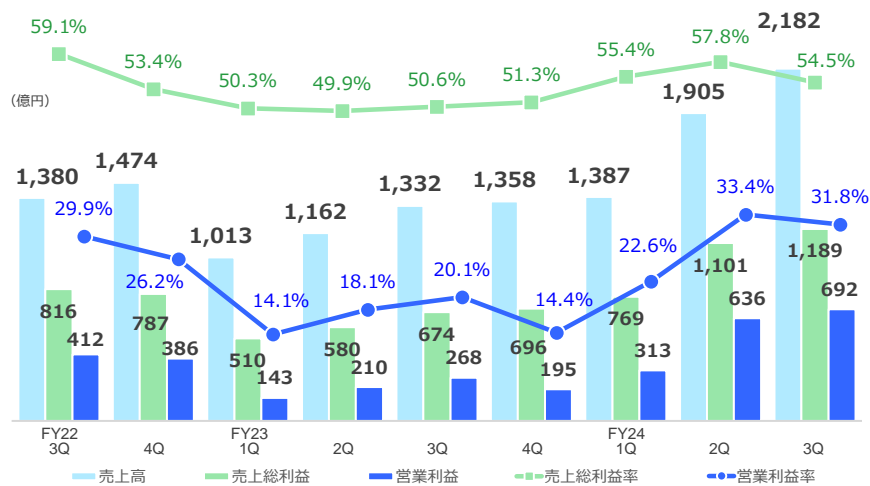
# 四半期売上高 地域(出荷先)別



## ○ FY2024 3Qの地域(出荷先)別売上高

- 台湾  
3Qも、主に米国の複数ファブレスにおけるハイエンドSoC向けでの品質保証強化を背景に、関連するファウンドリ・OSAT向けの売上がさらに伸長しました。
- 韓国、中国  
DRAM向けでメモリ・テスト売上が一段と伸長しました。

# 売上高/売上総利益/営業利益



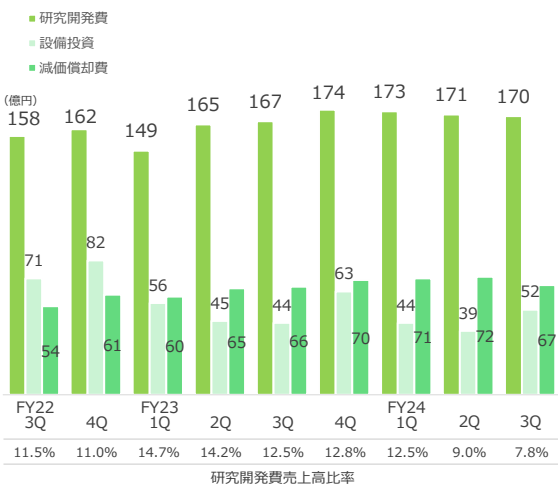
## ○ FY2024 3Qの売上高/売上総利益/営業利益

- 高い売上高を計上できたことから、前期に引き続き営業利益率が30%を超えました。
- 一方で、売上総利益率は前期比で低下しています。これは主に、製品ミックスの変動、需要が低調なAI用途以外のテストで棚卸評価損を計上したこと、などによるものです。
- 販売費および一般管理費等（その他収益・費用を合算）は増収に伴う費用増などにより、497億円となりました。

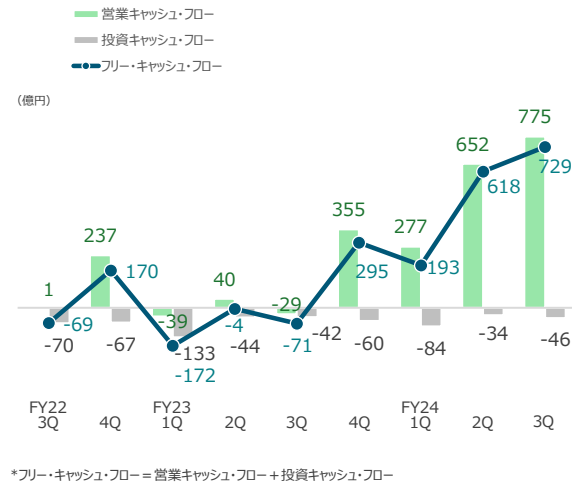


# 投資等/キャッシュ・フロー

## <投資等>



## <キャッシュ・フロー>



### ○ FY2024 3Qの研究開発費等

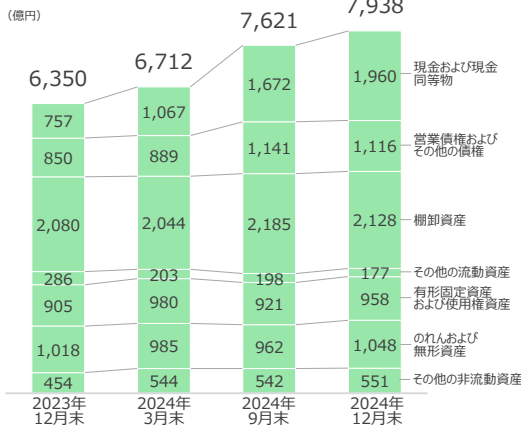
- 研究開発費、設備投資、減価償却費はご覧の通りです。
- 設備投資が前期比で増加しました。これは主に、第3期中期経営計画で示したオペレーショナル・エクセレンス推進に関連する投資によるものです。

### ○ FY2024 3Qのキャッシュ・フローの状況

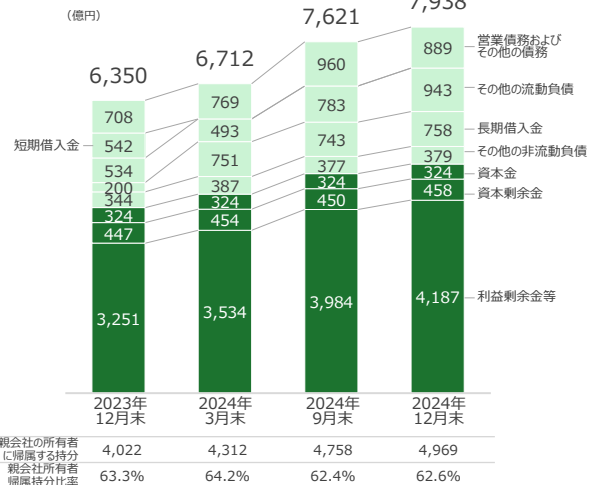
- 高水準な売上および利益が計上される中で、営業キャッシュ・フロー、フリー・キャッシュ・フローが増加しました。

# 連結財政状態

## <資産の部>



## <負債・資本の部>



## ○ 2024年12月末時点のバランス・シート

- 棚卸資産は、当社製品の出荷が進捗したことから、前期比で減少しました。地政学リスクをはじめとした不透明な事業環境下にもあることから、引き続き棚卸資産管理に取り組んでまいります。
- なお本日適時開示した通り、10月に発表した自己株式の取得は、上限の500億円に達したため、昨日終了いたしました。取得した自己株式総数は約571万株、総額は約500億円です。
- 今後も成長投資と資本効率性のバランスを考慮したバランスシート・マネジメントを行ってまいります。
- 私の発表は以上です。引き続き、FY2024の事業見通しについてダグラスより説明いたします。

# 2024年度事業見通し

代表取締役 兼 経営執行役員  
Group CEO

Douglas Lefever

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION

**ADVANTEST**®

## 事業環境と半導体テスト市場の動向 <2025年1月時点の見方>

### CY25 事業環境

- 半導体市場は、CY24に引き続き、主にAI関連向けが半導体需要をけん引すると予想
- 一方、地政学リスクの上昇に伴い、先行きの不確実性が増加

### CY25 半導体テスト市場

- CY24の市場規模は、当社のテスト供給能力増強を中心に、前回推定値から引き上げ
- CY25は、AI関連向けテストの高水準な需要は継続すると見込むが、自動車や産業機器向けなどのテスト需要回復にはなお時間を要する見通し

	CY23実績	CY24実績（暫定）	CY25推定
SoCテスト市場	約\$3.3B	約\$3.9B - 4.0B (2024年10月時点推定: 約\$3.5B - 3.8B)	約\$4.2B - 4.8B
メモリ・テスト市場	約\$1.1B	約\$1.9B - 2.0B (2024年10月時点推定: 約\$1.7B - 1.9B)	約\$1.7B - 2.2B

Source: Advantest

## ○ 事業環境と半導体テスト市場

- まず、事業環境について説明いたします。
- CY2025の半導体市場は、CY2024に引き続き、主にAI関連向けが半導体需要をけん引すると予想しております。ウェハおよび先進パッケージングの生産能力がさらに増しており、半導体の生産数量は増加し続けています。同時に、半導体の複雑化の進展は、テスト項目を増加させております。
- 一方、地政学リスクの上昇に伴い、先行きの不確実性が増しており、私たちは継続して注意深く状況を注視しております。
- 次に、この事業環境を踏まえ、半導体テスト市場の見通しについて説明いたします。
- CY2024の市場規模は、主に当社のテスト供給能力増強などにより、前回推定値から引き上げました。
- CY2025は、現時点でSoCテストの市場規模を42億米ドルから48億米ドル、メモリ・テストを17億米ドルから22億米ドルというレンジで予想しております。
- 自動車や産業機器向けなどのテスト需要回復にはなお時間を要する見通しであるものの、AI関連向けテストの高水準な需要は継続すると見込んでおります。

# FY24業績予想

(億円)									
	FY23	FY24							(参考)新旧FY24予想比較
	実績	1Q 実績	2Q 実績	3Q 実績	4Q 予想	通期予想	vs. FY23		2024年 10月時点
							増減額	増減率	修正額
売上高	4,865	1,387	1,905	2,182	1,926	7,400	+2,535	+52.1%	6,400
営業利益	816	313	636	692	619	2,260	+1,444	2.8x	1,650
営業利益率	16.8%	22.6%	33.4%	31.8%	32.1%	30.5%	+13.7pts		25.8%
税引前利益	782	319	607	706	618	2,250	+1,468	2.9x	1,625
当期利益	623	239	454	519	463	1,675	+1,052	2.7x	1,220
当期利益率	12.8%	17.2%	23.9%	23.8%	24.0%	22.6%	+9.8pts		19.1%
基本的EPS*1 (円)	84.45	32.35	61.56	70.30	63.53	227.74	+143.29	2.7x	165.01
研究開発費	655	173	171	170	206	720	+65	+9.9%	720
設備投資	208	44	39	52	75	210	+2	+1.0%	220
減価償却費	261	71	72	67	60	270	+9	+3.4%	270
為替レート*2	1米ドル 1ユーロ	143 155	153 165	154 168	149 162	140 155	6円 円安 8円 円安		147 161

\*1: 当社は、2023年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。上記の基本的EPSはFY23期首に株式分割が行われたと仮定しての数値を記載しています。業績予想における「基本的EPS」は、2024年12月31日現在の「期末発行済株式数(自己株式を含む)」から「期末自己株式数」を除いた株式数を、期中平均株式数とみなして算定しております。また、FY24 4Q業績予想の数値は通期予想からFY24 3Qまでの実績を差し引き、算出しております。

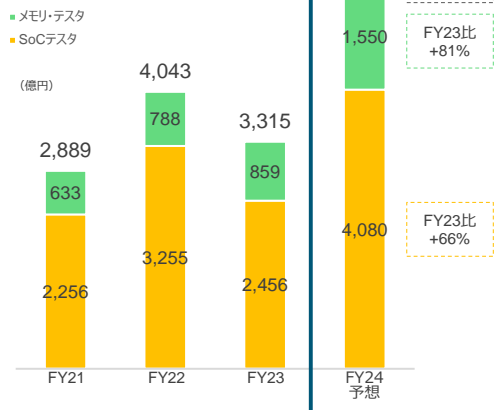
\*2: 為替レート変動が今年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、対米ドルが1円安時+13億円です。対ユーロは-3億円です。

## ○ FY2024の業績予想

- ご覧の通り、通期予想を売上高7,400億円、営業利益2,260億円、税引前利益2,250億円、当期利益1,675億円へと上方修正いたします。
- 売上高の上方修正は、主に、当社がコア部品の長期契約やサプライチェーンの複線化などの施策を通じて、タイムリーな部品調達や製品供給能力を確保したことによります。これにより、4Qも、SoCを中心とするAI関連半導体向けの引き続き旺盛なテスト需要に加え、従来予想に織り込み切れなかった需要増に追従できる目途が立ちました。また、円安も追い風となりました。
- 通期の売上総利益率は56%程度を予想しており、前回予想から微増を見込みます。
- 複雑化が進む半導体向けでの顧客の課題解決を志向する、新たなテスト・ソリューションの開発・評価など、高成長領域に向けたテストの付加価値向上に戦略的な投資を実施してまいります。
- なお、4Qの予想の前提とした為替レートは、米ドルが140円、ユーロが155円です。レート変動が2024年度の営業利益に与える影響の最新見通しは、通期で対米ドルでは1円安時+13億円、対ユーロでは-3億円です。
- 期末配当は、1株当たり20円を予想しています。中間配当実績19円と合わせ年間39円です。前年度比で+4.75円の配当となる見通しです。
- 次に、売上予想の詳細を説明いたします。

# FY24見通し（事業別）

半導体・部品テストシステム事業  
売上高推移



## 半導体・部品テストシステム事業

### <SoCテスト>（2024年10月予想比 +840億円）

- HPC/AI向け顧客の納期要求に追従すべく、製品供給ペースを引き上げ、売上見通しを増額

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
コンピューティング・通信	60%	65%	60%	90%
車載・産業機器・民生・DDIC*	40%	35%	40%	10%

\* DDIC:ディスプレイ・ドライバーIC

内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

### <メモリ・テスト>（2024年10月予想比 +90億円）

- 当社の製品供給体制を段階的に整備し、DRAM向けでの顧客の旺盛な投資意欲に対応

アプリケーション別内訳	FY21	FY22	FY23	FY24(予)
DRAM	60%	60%	90%	95%
不揮発性メモリ	40%	40%	10%	5%

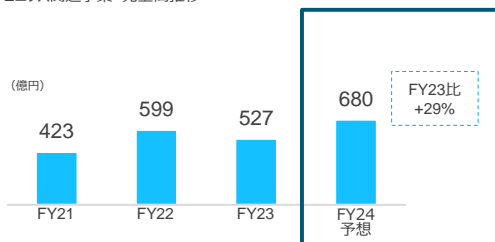
内訳比率は実数ではなく、5%近似値で丸めて表示しています

## ○ 半導体・部品テストシステム事業の今期見通し

- ・ SoCテストのFY2024売上予想を、10月の見通しから840億円引き上げ、4,080億円とします。
- ・ HPC/AI向け顧客の納期要求に追従すべく、サプライチェーン管理の高度化に努め、製品供給ペースのさらなる引き上げの目途が立ったことから、売上見通しを増額しました。
- ・ メモリ・テストのFY2024売上予想は、10月の見通しから90億円引き上げ、1,550億円とします。
- ・ 昨年から取り組んでいる製品供給体制の整備は、期を追うごとに順調に推移し、DRAM向けでの顧客の旺盛な投資意欲にタイムリーに対応し増収を見込みます。

## FY24見通し（事業別）

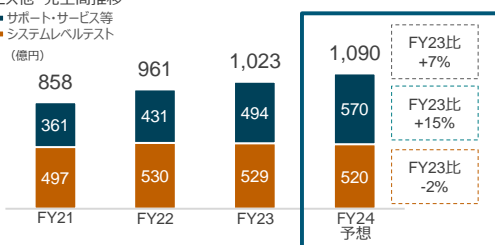
メカトロニクス関連事業 売上高推移



### メカトロニクス関連事業 (2024年10月予想比 +30億円)

- テスタ需要増と連動し、デバイス・インタフェースの売上は前年度比で増加見通し
- ナノテクノロジー製品も堅調な販売を見込む

サービス他 売上高推移



### サービス他事業 (2024年10月予想比 +40億円)

- 当社製品の設置台数の着実な伸びにより、サポート・サービスの需要は堅調
- システムレベルテストは、スマートフォン需要の不透明感継続を背景に前年度並みの売上を見込む

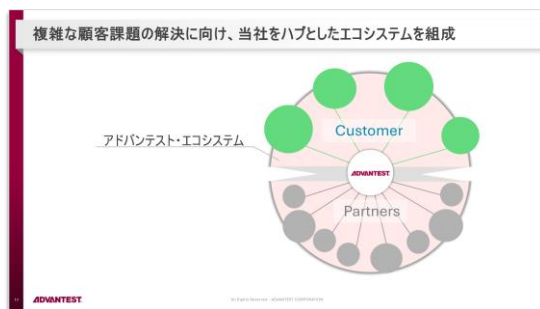
## ○ メカトロニクス関連、サービス他事業の今期見通し

- ・ メカトロニクス関連事業のFY2024売上予想は680億円です。
- ・ テスタ売上の伸びに伴い、デバイス・インタフェースの売上も前年度比で増収見込みです。
- ・ また、ナノテクノロジー製品も堅調な販売を見込みます。
- ・ サービス他事業のFY2024売上予想は、1,090億円です。
- ・ サポート・サービスでは、当社製品の設置台数の着実な伸びを受けて、底堅い需要を見込みます。
- ・ SLT事業では、スマートフォン向け需要の不透明感が継続していることから、前年度並みの売上を見込みます。
- ・ 一方、私たちは、中長期的な売上拡大に向け、顧客拡大への取り組みを続けております。HPC/AI関連などでは、半導体の複雑化、高信頼性要求を背景に、新たにSLT、Burn-in、高品質デバイス・インタフェースなどの需要が高まっております。ソリューション開発に向けて顧客と協議を進める一方、供給能力の拡大も進めてまいります。
- ・ SLTでは、複数の新規主要顧客を獲得しており、FY2025後半から業績に貢献し始めると予想しております。消耗品であるテスト・ボード事業では、高性能品の生産拠点として台湾の工場を稼働させ、生産を拡大します。

## 戦略的パートナーシップ契約を締結

### ■ Technoprobe社およびFormFactor社との戦略的パートナーシップ契約を締結（2025年1月9日発表）

- ✓ 技術およびプリント基板(PCB)製造に関する協業を含む
- ✓ 主要プローブカード・メーカーである両社への投資およびパートナーシップにより、顧客が信頼性の高いプローブカード・メーカーにアクセスできる環境を確保
- ✓ 同時に、当社は技術協力を通じて顧客の将来ニーズに応える高性能なテスト・ソリューション実現を図る
- ✓ 主にHPC(High Performance Computing)用半導体などにおいて、テストの複雑性増加が業界課題
- ✓ 当社は、この課題解決に向け、当社をハブとしたエコシステムを組成し、顧客により高性能なテスト・ソリューション提供を図る方針



▲中長期経営方針説明会資料より(2024年6月25日)

### ○ 戦略的パートナーシップ契約を締結

- 当社は、今月9日に、Technoprobe社およびFormFactor社との戦略的パートナーシップ契約締結を発表いたしました。
- このパートナーシップは、技術および製造に関する協業を含みます。主要プローブカード・メーカーである両社への投資およびパートナーシップにより、顧客がベストなウェハ・テスト・ソリューションにアクセスできる環境を確保いたします。
- 主にHPC用半導体などにおいて、テストの複雑性増加が業界課題となっております。当社は、昨年6月の中長期経営方針説明会でお伝えしたとおり、この課題解決に向けて、より高性能なテスト・ソリューションをお客様に提供するためのエコシステムを構築していく考えであり、今後もこのエコシステムにおいてパートナーシップを拡大し、主要パートナーを増やしていく予定です。
- 私の説明は以上です。ご清聴ありがとうございました。



**ADVANTEST®**

All Rights Reserved - ADVANTEST CORPORATION